



放熱対策材料

Heat-spread Material

PHOTOFINER
フォトファイナー

放熱対策現像型ソルダーレジスト PSR®-4000HS シリーズ

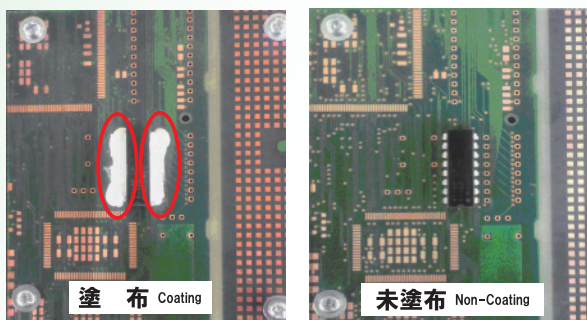
Photoimageable solder resist for Heat-spread

- 熱伝導率が一般のソルダーレジストの約 10 倍 ; 2.4W/m・K
Thermal conductivity: app. 10 times higher (compared with general solder resist : 2.4W/m.K)
- プリント配線板による放熱が可能 Heat spread function by PCB itself
- 高い光反射率から LED 実装基板に対応 Y 値 :71
Higher reflection for LED application (Y-value 71)
- 課題であった解像性・ハレーション・現像性を改良
Modified ink improved conventional problems, upgraded resolution and halation

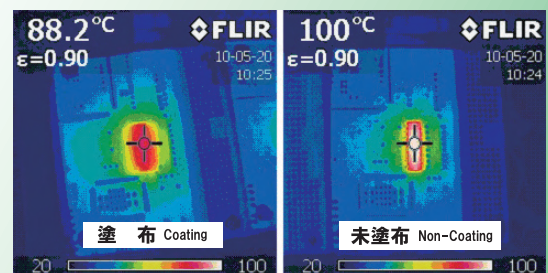
UV硬化型放熱ペースト

UV-curable Heat-spread Paste

- 放熱性に優れ冷却効果がある Excellent heat-spreading with cool-off effect
- 有機溶剤を含有しない Solvent-free
- 紫外線による速硬化タイプ UV type — quick curing process
- 1.4mm 超の厚膜硬化が可能 Applicable to high thickness application over 1.4mm
- 絶縁性を有する Insulation material
- シロキサンフリー Siloxane-free
- 一液性でハンドリングに優れる One-component type
- 熱伝導率 3.2W/m・K Thermal conductivity: 3.2W/m・K



塗布状態 Coating condition



サーモグラフィ画像 Therm graph

実験条件 Test condition 熱源 Heat source :1kΩ DIP 印加電圧 Loading :19V